

目次

- 1章 半導体プロセスとCMP
- 2章 CMPのメカニズム
- 3章 CMPの力学的要因
- 4章 研磨布の役割と機能
- 5章 超微粒子研磨剤の特徴と製造法
- 6章 CMP後の表面状態の測定とその清浄化
- 7章 SiのCMP
- 8章 絶縁膜のCMP
- 9章 W膜のCMP
- 10章 Al, Cu膜のCMP
- 11章 CMPの将来展望

発行 1997/08/20

サイズ A4

ページ数 373

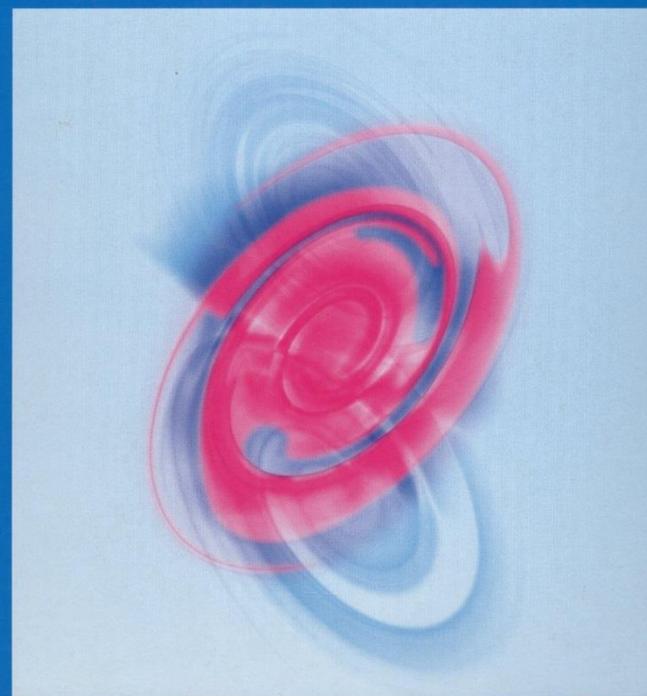
ISBN 916164-05-9 C3043

本体 44000円(税別)

サイエンスフォーラム

CMPのサイエンス

編集委員長 柏木正弘



サイエンスフォーラム